

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2023-19

成都高新发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,280,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨砚琪	张涵洁	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道 8 号	四川省成都高新区九兴大道 8 号	
传真	(028) 85184099	(028) 85184099	
电话	(028) 85137070	(028) 85130316	
电子信箱	yyq-gxfz@sohu.com	zhjgxfz@163.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

2022 年 6 月，公司通过并购整合在 IGBT 领域具备较强技术实力的成都森未科技有限公司（以下简称森未科技），正式进入功率半导体行业，公司主营业务增加功率半导体业务。功率半导体业务为公司战略转型确立的具备硬核技术的新主业，建筑业是公司目前第一大收入及利润来源，是公司打造强大功率半导体主业的坚实基础。

1、建筑业

（1）主要业务及其变化

①概述

公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式（EPC 模式），通过竞标形式获得。报告期内，公司紧紧抓住成都高新区全力推进新经济活力区、电子信息产业功能区、天府国际生物城、交子公园金融商务区和未来科技城全域五大产业功能区建设的巨大机遇，大力提升建筑施工业务规模和效益，在成都高新区五大产业功能区建设的实施阶段，倍特建安紧密围绕其建设需求，整合外部资源，联合多家业内知名建筑设计院，以 EPC 模式陆续承揽并顺利实施多个重大优质项目，承接业务量保持稳健增长，经营业绩稳定增长。2022 年倍特建安荣获“2022 年度成都市建筑业先进企业”等荣誉。公司将在持续服务于成都高新区建设的同时，在管理、人员等匹配情况下稳妥拓展区外业务，抓住城市产业升级建设机遇，不断提升建筑业务收入规模和利润水平，将其打造为公司的业务发力和重要利润支撑，为公司拓展具有发展前景的战略新兴产业功率半导体业务打下坚实基础。

截止 2022 年 12 月 31 日，倍特建安通过工程总承包与施工总承包模式承揽的累计已签约未完工订单达 93 个，金额约 255.29 亿元，为公司以后年度的利润来源提供了可靠保障。

②业务模式及风险

模式类型	模式描述	特有风险
施工总承包	建设方将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。	资金风险：房建项目居多，故受房地产市场整体环境波动影响较大，建设方资金链出现问题则给施工方带来工程款回收困难、资金压力增大、工程成本增加等经营风险； 盈利风险：准入门槛较低，恶性竞价剧烈，项目利润率较低。
工程总承包（EPC 模式）	工程总承包企业依据合同约定，对建设项目的设计、采购、施工、试运行完成全过程或若干阶段的承包任务。	全过程总控风险：工程项目建设周期长、投资多，金额大、技术要求高，系统复杂的生产建设过程，存在大量的不确定因素风险。在 EPC 模式下，参建单位增加，建设生产过程的组织集成化要求高，存在联合体内部协调机制的各种风险，比如设计与施工分离导致投资增加风险、建设进度工期风险等。

报告期内，倍特建安新承接项目中工程总承包项目金额占新签合同金额的 98.66%，为公司建筑业现在的主要业务模式。工程总承包项目具有节约项目工期、把控项目总造价、提高施工图的设计质量及施工质量、更有利于提升项目盈利水平的优势，倍特建安通过承接工程总承包项目将逐步提高建设项目周期中的前端设计优化水平，统筹协调整合各类优质资源，提升毛利率水平，持续提升公司核心竞争力。

（2）融资情况

报告期内，公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作，不断增加公司授信额度，并开展供应链金融，积极拓宽多品种融资渠道，确保公司生产经营的资金需求。

（3）质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

①执行质量标准和质量控制体系

GB/T19001 -2008《质量管理体系--要求》

GB/T50430-2007《工程建筑施工企业质量管理规范》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》

GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》

倍特建安 2009 年通过国际质量体系 ISO9001 认证以来，每年均通过北京中建协认证中心有限公司的监督评审。

②质量控制措施

倍特建安主要采取的质量控制措施包括：明确“过程精品、业主满意”的质量方针，制定质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职权落实到位。建立完善的质量保证体系，配备完整、高素质的项目管理人员，强化“项目管理，以人为本”的指导思想。开展全面质量管理，严格过程控制和程序控制，加强施工工艺质量控制，做到“标准化、规范化、

制度化”。严格执行样板制、三检制、工序交接制、质量检查验收制等。建立以总工程师、技术部以及项目技术负责人组成的技术管理体系，施工前编制实施性施工方案，加强施工方案的评审，严格审核其工艺和顺序，确保施工质量。利用计算机进行项目管理和质量管理，强化质量检查和验收，加强质量管理的基础性工作。加强图纸自审、会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程的施工质量。严把材料（包括原材料、成品、半成品）和设备出厂质量关、进场质量关。建立施工机械管理制度和各种机械设备的操作规程，对施工机械做到“定人定机”的管理，保证现场机械始终处于受控状态。加强影响工序质量因素的控制来实施施工过程中的质量控制，对关键工序和重要部位，根据工艺本身的特殊要求，设置质量控制点，通过对质量控制点的监控确保工序质量。做好施工测量及试验工作。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。做好施工技术文件、资料的整理工作。加强工序验收手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。施工过程中发现不合格品，应立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、监理等单位，对工程进行最终的检验和验收。

③整体评价

倍特建安建立的质量控制体系运行是有效的，符合国际质量体系 ISO9001 认证要求。

报告期内，倍特建安通过 PDCA 科学管控实现项目全面质量管理，未发生重大质量事故。

（4）安全生产制度的运行情况

报告期内，倍特建安高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识。公司全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，围绕安全生产十五条内容，按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府和成都高新区党工委管委会重大决策部署，践行安全发展理念，严格执行安全生产相关法律法规和规章制度，按照狠抓安全生产措施落实，提高工程施工安全生产管理、风险防控及应急处置能力，为公司科学健康发展保驾护航。

报告期内，倍特建安严格按照安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。

2、功率半导体业务

为打造具有发展前景的新主业，2022 年公司收购在 IGBT 领域具备较强技术实力的森未科技，将功率半导体作为公司战略转型的突破口，布局功率半导体业务。

公司子公司森未科技的定位是在功率半导体领域专注 IGBT 等功率半导体器件的设计、开发和销售，掌握国际主流 IGBT 芯片设计技术和加工工艺，以通用产品支撑规模，以高端产品实现高附加值。目前森未科技处于功率半导体产业链中上游，面向客户提供 IGBT 器件、IGBT 检测方案、IGBT 应用方案。作为公司打造 Fab-Lite 模式的重要载体，成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未半导体）定位为功率半导体器件及组件特色产线建设的主体，正在建设功率半导体器件局域工艺线和高可靠分立器件集成组件生产线，业务方向是为各领域/市场客户提供 IGBT 特色高端定制化模块及配套组件代工制造服务，主要面向新能源车、新能源发电（光伏/风力）及工控领域，通过产线建设旨在搭建企业一体化制造、测试、中试、验证平台，实现从芯片特色工艺到模块、组件的一条龙中试、量产能力，推动产品快速高效迭代，充分挖掘 IGBT 产品能力和潜力，服务产业链上下游客户。功率半导体器件局域工艺线注重超薄晶圆和高能注入等特色工艺研发攻关，是 IGBT 产品核心竞争力的重要工艺支撑，公司已充分掌握上述超薄晶圆和高能注入等特色工艺所需的核心技术。未来，随着功率半导体器件局域工艺线和高可靠分立器件集成组件生产线的建设完成，森未科技将充分利用芯未半导体的产能加快客户订单交付，打造差异化、特色化产品以提高市场竞争力，芯未半导体将优先响应森未科技需求，将其作为新增产能消化的有力支撑。公司将拥有 IGBT 等功率半导体芯片工程研制能力和集成组件封装能力，与标准晶圆及封装委外加工相结合，推动公司功率半导体业务兼具 IGBT 芯片设计、封装、生产能力，以相对较低的投入规模获得生产效率及产品竞争力的提升。

根据前述定位和发展路径，报告期内，森未科技结合自身能力和优势，持续强化研发设计能力，推进 IGBT 功率半导体国产化进程，联合芯未半导体打造 Fab-lite 经营模式（在晶圆制造、封装及测试环节采用自行建厂和委外加工相结合的方式），同时以市场为导向，深耕功率半导体细分应用领域，持续拓展功率半导体下游应用市场，以自主 IGBT 芯片为牵引，拥有包含近 100 个不同芯片规格的 IGBT 芯片库，产品电压等级覆盖 600-1700V，单颗芯片电流规格覆盖 5-200A，构建了 IGBT 器件、IGBT 检测方案、IGBT 应用方案三维一体的产品体系，并已应用于工业变频、电源、光伏、充电桩以及新能源车等多个市场领域。

（1）产品/服务

①IGBT 器件

森未科技 IGBT 器件系列产品全面采用沟槽栅+场截止技术，覆盖 600-1700V 以及低、中、高频应用领域，对标全球 IGBT 龙头英飞凌的同类芯片产品。其中，模块提供多种封装形式，包括 62mm、34mm、H 类、D 类、F 类、B 类等，可实现与国际主流厂商的 PIN TO PIN 替换；单管提供 TO-220F、TO-247、TO-3P、TO-264 等多种封装形式。产品已进入工业变频、高频感应加热、特种电源、新能源汽车、新能源发电市场。

产品规格	应用	应用领域简介	产品特征	图例
1,200V/10A-1,200V/600A 以及 1,700V/75A-1,700V/600A	工业变频	变频器是利用电力半导体器件的通断效果将工频电源转换为另一频率的电能控制设备。IGBT 有着驱动简单、高开关频率、低损耗、高可靠等特点，是变频器的核心器件，在行业内广泛使用。在新型工业化发展战略的推动下，节能降耗已经成为降低生产成本、提高产品竞争力的重要手段之一。使用变频器的电机系统较定频系统节电率普遍达 20%左右，某些较高场合可达 30%以上，节能效果非常显著。可以说，变频器已经成为电机节能的发展方向，其市场潜力巨大。	沟槽栅+场截止技术更低的杂散电感设计最优的 VCE (sat) 和 Eoff 折中 正温度系数	
1,200V, 40A-3,000A	高频感应加热	感应加热过程主要是依靠电流感应透热及热传导的方式实现，可在很短的时间内将工件加热到预期温度，在工业领域有着广泛的应用。目前，感应加热已广泛应用于钎焊、淬火、退火、金属熔炼、热处理、机械制造、轻工及电子类的加工等行业。此外感应加热已逐渐进入到人们的家庭生活中，例如微波炉、电磁炉、热水器等。现在，感应加热正朝着大功率和高频率相统一的方向发展，因此采用新型功率 IGBT 器件十分必要。	低 VCE (sat) 低开关损耗 正温度系数，易于并联使用	
1,200V, 200A-450A	特种电源	由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源，或者是输出电压特别高，输出电流特别大，或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高，或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求。这就使得在设计及生产此类电源时比普通电源有更特殊甚至更严格的要求。特种电源一般是为特殊负载或场合要求而设计的，它的应用十分广泛。主要有：电镀电解、阳极氧化、医疗设备、电力操作、电力试验等等。大功率开关器件采用先进的 IGBT 模块及先进可靠的驱动电路，使得电源的整体性能良好，稳定度好，并且具有各种保护功能。	优化的 VCE (sat) 和 Eoff 折中 正温度系数，易于并联使用 更优的电路设计，整体方案优化	
1,200V, 450A-600A	电动汽车	IGBT 具有高频率、高电压、大电流、易于开关等优良性能，被业界誉为功率变流装置的 CPU，IGBT 是电动汽车中的核心器件之一，是动力系统的重要组成部分。IGBT 在电动汽车中主要应用于以下几个方面：电机控制系统（大功率直流/交流逆变后驱动汽车电机、充电系统（充电桩直流/交流及车载充电器）、车载空调系统（小功率直流/交流驱动空调压缩机）	卓越的 VCE (sat) 和 Eoff 带 NTC，实现芯片温度检测 优异的散热设计 高鲁棒性和可靠性	
6,00V/50A, 75A 系列, 1,200V/40A, 75A, 150A, 200A 系列 1,700V 系列	新能源发电	新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能等等，环保和可再生为特质的新能源产业越来越得到各国的重视。中国的新能源主要包括水能（主要指小型水电站）、风能、生物质能、太阳能等。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。	超高功率密度低电感设计低开关损耗低 VCE (sat) 低热阻	

②IGBT 检测方案

IGBT 检测方案依托于森未科技建立的 IGBT 芯片和器件检测分析平台（成都市高新区“IGBT 公共技术平台”），平台主要设备包括芯片全自动制样设备、高倍光学显微镜、扫描电子显微镜、晶圆探针台、功率器件曲线追踪仪、功率器件动态测试机等，涵盖芯片微观结构、芯片/晶圆静态电学参数、器件静态参数、动态参数、绝缘耐压等一系列项目测试，并且能够开展器件失效分析和逆向分析的整套流程。

森未科技建立并不断拓展 IGBT 器件应用测试平台，以团队自主开发为主，先后开发了通用型老化测试平台（包括功率循环测试平台和高温反偏平台等）、80KW 逆变并网及无功测试平台、变频器对拖测试平台、感应加热类应用测试平台等一系列针对不同用户和应用场景的测试平台，旨在保障器件在终端客户的使用和优化，追求产品性能和可靠性的精益求精。

③IGBT 应用方案

森未科技测试应用团队成员均为行业器件应用的资深专家，具备十年以上的 IGBT 器件现场应用经验，目前已有多个领域的成熟应用方案，也可根据客户工况，定制开发产品应用方案，主要涵盖了通用变频器解决方案、感应加热解决方案、新能源 & 高频电源解决方案。通用变频器解决方案具备针对电机驱动应用优化器件损耗和 dv/dt、电压等级涵盖 600V~1700V、电流等级 10A~600A 以及兼容市场主流封装最低 10us 短路能力等性能特点，已有 20 类产品；感应加热解决方案具备针对应用特点优化了器件关断损耗和导通损耗和适合高频应用、优化了关断拖尾电流并降低损耗、电压等级

覆盖 600V~1350V、电流等级覆盖 40A~150A 以及兼容市场主流封装等性能特点，已有 6 类产品；新能源&高频电源解决方案，其中新能源解决方案具备针对应用特点优化了器件损耗并提高系统效率、优化了器件 EMI 特性并降低系统噪声、电压等级涵盖 600V~1700V、电流等级 15A~600A、兼容市场主流封装以及最低 10us 短路能力；高频电源解决方案具备采用最新精细化 Trench+FS 工艺和低导通压降（1.4V）、低开关损耗和高开关频率使用、电压覆盖 600V~650V 以及电流等级覆盖 50A~75A 等性能特点，已有 5 类产品。

（2）主要下游应用市场拓展情况

森未科技拥有一支“一体两翼”的产品经营团队，以产品线经营为主体，市场中心和销售中心为两翼，建立了将客户需求快速有效地转化成产品的新产品开发机制，团队核心成员不仅有内部培养掌握公司技术参数和产品性能的产品管理专家和产品应用专家，还引进了多名具备丰富经验的销售管理人员和产品经理，能够快速、准确地理解客户的个性化需求，并将这种需求转化为产品要求，支持公司产品线的持续更新，为客户提供整体解决方案，加大客户粘性，长期稳定合作，不断为客户创造价值。2022 年，森未科技深入变频器、有源电力滤波器（APF）、光伏逆变等电力电子领域，依托深厚的技术研发储备和科学严谨的质量管理体系，屡获业内头部客户认可，储备了电源、变频器、激光焊接、电池检测、光伏、储能和新能源汽车等各应用领域的上百家客户，推动公司在工业控制领域、新能源汽车以及风光储市场的拓展：

①工业控制应用领域。森未科技是国内最早推出采用自主芯片的 1200V/450A 等大功率模块的企业之一。早在 2019 年，森未科技就全面开发了 650V-1700V 系列化芯片，进入工业控制应用领域的工业变频和特种电源应用场景。该系列产品具有 Trench+FS 技术、高短路耐量、低损耗等特点，目前已具备提供多种形式的封装能力，并且开始向伺服市场拓展。

②新能源汽车应用领域。新能源汽车作为 IGBT 最重要的市场之一，早在 2020 年森未科技推出的 1200V IGBT 模块就已在深圳新能源车客户的电动车上进行了急加速、急减速、长时间爬坡等共计上万公里的整车测试并顺利通过所有测试项目。森未科技自有的 1200V 450A/600A 等 IGBT 模块也已陆续投入新能源车市场。同时，在 OBC、车载 PTC 项目，森未科技自有的 IGBT 单管已经通过了全球知名的新能源车厂的认证和测试。森未科技也将持续开展车规级 IGBT 的研发与应用，力求在新能源汽车换道超车的历史机遇中赢得一席之地。

③风光储应用领域。IGBT 作为光伏、储能逆变器新能源发电领域的核心器件，森未科技在 2021 年已推出高功率密度系列产品，瞄准光伏逆变、光伏储能等市场，并作为公司重点项目持续投入研发。目前，公司研发的 650V-1200V 高频单管以及三电平系列模块产品已向光伏市场推出，并已通过国内光伏储能企业的验证，截至目前已实现小批量供货。

综上，森未科技坚持以市场和客户需求为导向，通过不断的研发和技术创新，提供满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体产品，为客户提供优质的服务并依靠自身人才、技术等基础优势的长期积累，成熟运用芯片的核心设计技术，成功实现了产品形态延伸，形成了多类型 IGBT 产品布局，同时通过建立 IGBT 芯片和器件检测分析平台，涵盖芯片级、器件级、应用级的各项测试内容，测试水平达到国际标准，满足客户对产品性能及质量的要求。产品与服务深入工业控制应用、新能源汽车应用以及风光储应用三大应用市场，覆盖地域由四川、广东逐渐分布至上海、浙江、南京、西安、武汉、山东等地，出口至韩国、日本、新加坡等国家，渠道和品牌效果开始展现。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	13,677,871,066.54	10,828,274,340.73	26.32%	8,338,949,498.00
归属于上市公司股东的净资产	1,751,125,495.04	1,558,202,228.37	12.38%	1,535,196,625.75
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	6,570,599,836.21	6,611,796,782.29	-0.62%	5,533,078,836.61
归属于上市公司股东的净利润	199,070,118.38	163,348,056.32	21.87%	240,838,411.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,612,602.82	135,104,239.70	-1.10%	179,089,949.23
经营活动产生的现金流量净额	139,660,008.16	458,904,109.68	-69.57%	160,279,652.10
基本每股收益（元/股）	0.565	0.464	21.77%	0.765
稀释每股收益（元/股）	0.565	0.464	21.77%	0.765
加权平均净资产收益率	12.03%	10.65%	1.38%	20.73%

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	890,499,723.09	1,493,774,312.17	1,747,796,447.49	2,438,529,353.46
归属于上市公司股东的净利润	11,505,701.63	56,608,978.71	14,920,912.71	116,034,525.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,039,375.15	56,321,609.75	8,594,284.08	57,657,333.84
经营活动产生的现金流量净额	-464,353,070.71	-153,977,270.85	-50,893,674.29	808,884,024.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,802	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.88%	172,207,860	145,285,560	不存在质押或冻结情况		
成都高新未来科技城发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况		
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况		
朱永存	境内自然人	1.30%	4,567,123	0	不存在质押或冻结情况		
成都产业投资集团有限公司	国有法人	0.89%	3,120,000	0	不存在质押或冻结情况		
徐功荣	境内自然人	0.69%	2,429,500	0	不存在质押或冻结情况		
刘馨莲	境内自然人	0.60%	2,126,469	0	不存在质押或冻结情况		
徐永才	境内自然人	0.53%	1,880,100	0	不存在质押或冻结情况		
朱永财	境内自然人	0.49%	1,741,700	0	不存在质押或冻结情况		
刘芝芳	境内自然人	0.47%	1,650,000	0	不存在质押或冻结情况		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司。						

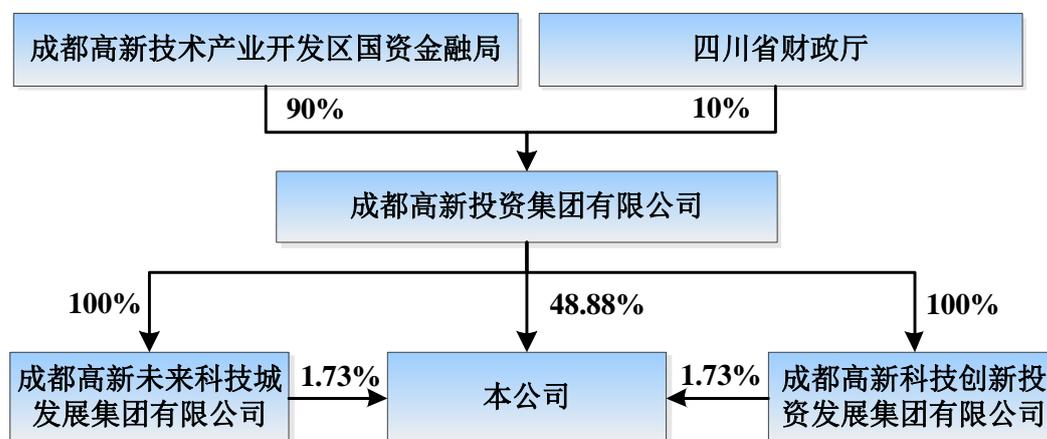
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用
--------------------	-----

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司及全资子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特开发）以现金 28,230.7722 万元购买森未科技股权及其上层股东权益，交易完成后，公司以直接和间接方式控制森未科技 69.401%的股权，取得森未科技控制权；公司以现金 1,175.9706 万元购买高投集团持有的芯未半导体 98%股权，由此公司正式进入功率半导体行业。相关公告详见 2022 年 6 月 1 日、6 月 20 日、2022 年 7 月 1 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、第八届董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议、第八届董事会第六十次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过，募集资金扣除发行费用后将用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目及补充流动资金。中国证监会于 2023 年 2 月 17 日公布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》，截至披露日，本次向不特定对象发行可转换公司债券已获深交所受理，尚在审核中，需获得深交所审核通过并且中国证监会作出同意注册的决定后方可实施（相关公告详见 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 6 日、2022 年 12 月 14 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 27 日和 2023 年 3 月 3 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

3、公司于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议同意公司、公司控股子公司倍特投资和控股股东高投集团子公司高投资管同时以非公开协议转让方式将合计持有的倍特期货 55%股权以 43,750.762 万元价格转让给成都交子金融控股集团有限公司，其中公司以 167.048 万元转让持有的倍特期货 0.21%股权，公司控股子公司倍特投资以 32,653.978 万元转让持有的倍特期货 41.05%股权，高投资管以 10,929.736 万元转让持有的倍特期货 13.74%股权。详见 2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。根据《期货公司监督管理办法》等相关法律法规，本次转让倍特期货控股权尚需经中国证券监督管理委员会批准。截至披露日，本次转让倍特期货控股权事项尚在中国证券监督管理委员会审核中。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：任正

二〇二三年四月八日